

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于盛合晶微半导体有限公司

### 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation，以下简称“盛合晶微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对盛合晶微使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年3月3日出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕373号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,546.6162万股，发行价格为人民币19.68元/股，本次募集资金总额为人民币5,027,574,068.16元，扣除发行费用人民币248,973,009.21元（含增值税），实际募集资金净额为人民币4,778,601,058.95元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年4月15日出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0052号）。

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

据《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以

下简称“《招股说明书》”)以及公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-008),公司募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	三维多芯片集成封装项目	840,000.00	400,000.00	398,216.75
2	超高密度互联三维多芯片集成封装项目	300,000.00	80,000.00	79,643.35
合计		<b>1,140,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>477,860.11</b>

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

根据《招股说明书》,本次发行募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

### 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

#### (一) 自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年4月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币884,236.36万元,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	调整后拟使用募集资金投入金额	自筹资金已预先投入金额	拟置换金额
1	三维多芯片集成封装项目	840,000.00	398,216.75	614,929.04	338,216.75
2	超高密度互联三维多芯片集成封装项目	300,000.00	79,643.35	269,307.31	79,643.35
合计		<b>1,140,000.00</b>	<b>477,860.11</b>	<b>884,236.36</b>	<b>417,860.11</b>

注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致；

注 2：上述以自筹资金预先投入募投项目的总额 884,236.36 万元为项目经董事会审议确定为募投项目后的投资金额，不包括董事会审议前已支付的金额。

## （二）已支付发行费用情况及置换安排

公司本次发行的各项发行费用合计人民币 24,897.30 万元（含增值税），截至 2026 年 4 月 15 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,043.20 万元（含增值税），本次拟使用募集资金一并置换。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	费用明细	自筹资金预先支付发行费用金额（含增值税）	本次拟置换金额
1	保荐承销费用	477.00	477.00
2	审计及验资费	1346.20	1346.20
3	律师费	200.00	200.00
4	上市相关的手续费等其他费用	20.00	20.00
合计		<b>2,043.20</b>	<b>2,043.20</b>

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行鉴证，并出具了《关于盛合晶微半导体有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1255 号）。

## （三）募集资金置换总额

公司拟使用募集资金合计人民币 419,903.31 万元置换上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项。

## 四、相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用合计募集资金人民币 419,903.31 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集

资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

## **（二）审计委员会审议情况**

公司于2026年5月29日召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

## **五、专项意见说明**

### **（一）会计师事务所鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

## **六、保荐机构核查意见**

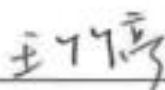
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于盛合晶微半导体有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



王竹亭



李扬

